

認証書付属書

表1 認証試験板厚の溶接条件データ
 (最小及び最大ルート間隔の場合)

梁フランジ板厚 (mm)	× 通しダイアフラム 板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (cpm)	パス数
12×19		3.0	4~10 テーパー	278~280	32~35	25~29	3
			10	277~286	32~35	19~41	4
32×45		9.0	4~10 テーパー	271~289	31~35	20~40	14
			10	272~290	31~35	15~35	15

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

梁フランジ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (cpm)	パス数
9	0以上 3.0以下	4	250~310	31~37	20~40	2
		6	250~310	31~37	15~35	2
		10	250~310	31~37	10~40	3
12	0以上 3.0以下	4	250~330	31~39	20~45	3
		6	250~330	31~39	15~40	3
		10	250~330	31~39	10~45	4
16	0以上 4.0以下	4	250~330	31~39	15~45	4
		6	250~330	31~39	15~50	5
		10	250~330	31~39	10~55	6
19	0以上 5.0以下	4	250~330	31~39	15~40	5
		6	250~330	31~39	10~35	5
		10	250~330	31~39	5~45	6
22	0以上 5.0以下	4	250~330	31~39	10~45	6
		6	250~330	31~39	15~45	7
		10	250~330	31~39	10~45	8
25	0以上 5.0以下	4	250~330	31~39	15~50	8
		6	250~330	31~39	15~50	9
		10	250~330	31~39	10~45	11
28	0以上 5.0以下	4	260~330	32~39	10~40	8
		6	260~330	32~39	10~40	9
		10	260~330	32~39	10~45	11
32	0以上 5.0以下	4	260~330	32~39	10~40	10
		6	260~330	32~39	15~45	12
		10	260~330	32~39	10~40	14
36	0以上 5.0以下	4	260~330	32~39	15~45	13
		6	260~330	32~39	15~45	14
		10	260~330	32~39	10~45	16
40	0以上 5.0以下	4	260~330	32~39	15~45	15
		6	260~330	32~39	15~45	17
		10	260~330	32~39	10~45	20

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める (少数点以下は切上げ)。

※この溶接施工条件範囲は、認証された溶接条件 (40kJ/cm以下、パス間温度 350° 以下) で使用しなければならない。

※裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

※溶接施工条件範囲は代表的な開先条件時の範囲を示す。

認証書付属書(続き)

表3 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

梁フランジ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小、6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (cpm)	パス数
22	5.0 超 6.0 以下	4	230~330	29~39	10~45	6
		6	230~330	29~39	15~45	7
		10	230~330	29~39	10~45	8
25	5.0 超 7.0 以下	4	230~330	29~39	15~50	8
		6	230~330	29~39	15~50	9
		10	230~330	29~39	10~45	11
28	5.0 超 7.0 以下	4	230~330	29~39	10~40	8
		6	230~330	29~39	10~40	9
		10	230~330	29~39	10~45	11
32	5.0 超 8.0 以下	4	230~330	29~39	10~40	11
		6	230~330	29~39	15~45	14
		10	230~330	29~39	10~40	15
36	5.0 超 8.0 以下	4	230~330	29~39	15~45	15
		6	230~330	29~39	15~45	16
		10	230~330	29~39	10~45	18
40	5.0 超 9.0 以下	4	230~330	29~39	15~45	17
		6	230~330	29~39	15~45	19
		10	230~330	29~39	10~45	22

パス数は、表3に記載の10%増までのパス数を認める(少数点以下は切上げ)。

- ※この溶接施工条件範囲は、認証された溶接条件(40kJ/cm以下、パス間温度350°以下)で使用しなければならない。
- ※裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。
- ※溶接施工条件範囲は代表的な開先条件時の範囲を示す。